

半導体材料サプライチェーン・マネジメントシステムを構築

～ 経産省「デジタル技術を活用したサプライチェーンの高度化支援事業」活用 ～

株式会社レゾナック（社長：高橋 秀仁）は、半導体材料の生産や出荷等に関する情報の一元管理・可視化を目的に、サプライチェーン・マネジメントシステムの構築を進めています。

半導体材料 12 カテゴリーについて既に 7 カテゴリーの運用を開始し、残り 5 カテゴリーについても来年度末までに開始予定です。半導体が経済安全保障の観点から重要物資に位置づけられるなか、サプライヤーからお客さまに至るサプライチェーン上のリスクの早期検知や複数拠点間での連携強化による生産ラインの効率的稼働を目指します。

近年、経済安全保障の観点から重要物資に位置づけられる半導体は、そのサプライチェーンがグローバルに広がっているため、地政学的対立などによるサプライチェーンの途絶リスクが顕在化しています。一方で、サプライチェーン全体での CO₂ 削減や労働環境改善などへの対応も必要になっています。

こうした中、当社では製品を安定供給し且つ競争力を維持・強化していくために、サプライチェーン・マネジメントシステムの構築を進めています。今回の取り組みは、経済産業省の「デジタル技術を活用したサプライチェーンの高度化支援事業」に採択されました。

当システムは、製品や用途ごとの在庫、販売データなどをクラウド上で管理し、ユーザーはアプリから各情報にアクセスし、データの入力を行えます。また、製造のプロセス条件や CO₂ 排出量、製品品質から作業者の労働状態にいたるまで、各要素をデジタル化しモニタリングします。

これにより、市場環境や社会情勢によるサプライチェーン上のリスクを早期に検知できるほか、拠点ごとの生産状況を把握して各拠点の稼働を適切にコントロールし、必要に応じて複数拠点間で生産をカバーし合うことで、お客さまのニーズへの迅速な対応やリードタイムの短縮等を見込んでいます。加えて、近年お客さま等から求められるケースが増えている、環境負荷の情報開示や強制労働などの人権侵害を行っていないことの保証等についても、当システムの導入により迅速に対応できるようになる見込みです。

今後も当社は、調達から生産、デリバリーにいたる情報を可視化して一元管理することで、リスク対応を含めた事業判断のスピード向上、事業最適化を進めていきます。

※1 半導体パッケージ用モールド材、モールド用離型フィルム、銀ペースト、チップ接着フィルム、ソルダーレジスト、感光性フィルム、絶縁コーティング材

※2 積層基板材料、実装用材料、異方導電フィルム、CMP スラリー、放熱シート

以上

【Resonac（レゾナック）グループについて】

レゾナックグループは、2023年1月に昭和電工グループと昭和電工マテリアルズグループ（旧日立化成グループ）が統合してできた新会社です。半導体・電子材料の売上高は、全体の3割にあたる約4,000億円に上り、特に半導体の「後工程」材料では世界 No.1 の企業です。2社統合により、材料の機能設計はもちろん、自社内で原料にまでさかのぼって開発を進めています。新社名の「Resonac」は、英語の「RESONATE：共鳴する・響き渡る」と、Chemistry の「C」の組み合わせです。今後さらに共創プラットフォームを生かし、国内外の半導体メーカー、材料・装置メーカーとともに技術革新を加速させます。詳しくはウェブサイトをご覧ください。株式会社レゾナック・ホールディングス

<https://www.resonac.com/jp/>

◆ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社レゾナック・ホールディングス

ブランド・コミュニケーション部 広報グループ

TEL 03-6263-8002